



FACULTAD DE INGENIERÍA  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE CHILE

SEMINAR OF SELF-COMPACTING CONCRETE AND 3D PRINTING

**FONDECYT 1150251 – Grupo de Innovación en Construcción con Hormigón**

Monday 19th November, 2018 - Breakfast included

Sala Matte, Centro de Extensión UC, Av. Libertador Bernardo O'Higgins #390, Santiago

**FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN**

**IDENTIFICACIÓN**

Nombre: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

**DATOS DE FACTURACIÓN**

Razón Social: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Nombre de Contacto: \_\_\_\_\_

Fono: \_\_\_\_\_

**VALORES**

**PÚBLICO GENERAL**

Costo de inscripción: \$30.000

Cantidad de Inscripciones

\_\_\_\_\_

Valor exento de IVA

\$ \_\_\_\_\_

**ACADEMICOS**

Costo de inscripción: \$15.000

\_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_

**ESTUDIANTES**

Costo de inscripción: \$5.000

\_\_\_\_\_

\$ \_\_\_\_\_

VALORES INCLUYEN: COFFEE - MATERIAL DE APOYO

**TOTAL \$** \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**\* FORMAS DE PAGO**

**Importante: Favor complete su registro para cada participante y envíelo por mail a: Ximena Araya, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Escuela de Ingeniería, Ponticia Universidad Católica de Chile, RUT: 81.698.900-0, Casilla 306, Correo 22, Santiago, CHILE, Fax: (562) 686 4806 Fono (562) 686 4244 e-mail: jaraya@ing.puc.cl - ric@ing.puc.cl**

Directamente en Vicuña Mackenna 4860, Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción, Campus San Joaquín, Edificio San Agustín, Piso 3. También se puede cancelar a través de un depósito bancario a la cuenta N°2546901-1, Banco Santander a nombre de la Universidad (enviar cupón de depósito por fax o mail).

**ANULACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL DINERO:**

Hasta 48 horas antes del evento; posterior a ello no habrá devolución

**FACTURACIÓN:**

Posterior al evento y recibir el pago se enviará factura electrónica

\*\*\*\*\*